

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年1月26日
【会社名】	株式会社日立製作所
【英訳名】	Hitachi, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長兼CEO 小島 啓二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】	03-3258-1111
【事務連絡者氏名】	法務本部 部長代理 福谷 悠希
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】	03-3258-1111
【事務連絡者氏名】	法務本部 部長代理 福谷 悠希
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2023年10月27日、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、当社のITプロダクツ事業部門を新たに設立する日立ヴァンタラ株式会社に承継させる吸収分割（以下、「本吸収分割」といいます。）について臨時報告書を提出しました。

当社は、本日、本吸収分割に係る吸収分割契約を締結したことから、上記の臨時報告書において未定としていた内容等について開示するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

2 報告内容

(1)本吸収分割の相手会社についての事項

- イ 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ロ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
- ニ 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(3)本吸収分割の方法、割当ての内容、その他の本吸収分割契約の内容

- ロ 本吸収分割に係る割当ての内容
- ハ その他の本吸収分割契約の内容等

(4)本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

(5)本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

3【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

(訂正前)

(1)本吸収分割の相手会社についての事項

- イ 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日立ヴァンタラ株式会社(2023年11月設立予定)
本店の所在地	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
代表者の氏名	代表取締役社長 島田 朗伸
資本金の額	50百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	ストレージを中心としたデータインフラストラクチャ製品、データマネジメントソフトウェア、ハイブリッドクラウド基盤及びそれら関連サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

- ロ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
2023年11月設立予定であるため、現時点で終了した事業年度はありません。

ニ 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社の100%子会社として設立される予定です。
人的関係	当社の従業員が日立ヴァンタラ株式会社の取締役を兼務する予定です。
取引関係	本吸収分割の効力発生前は営業活動を行わないため、当社との取引関係は予定されていません。

(3)本吸収分割の方法、割当ての内容、その他の本吸収分割契約の内容

- ロ 本吸収分割に係る割当ての内容
現時点では確定していません。

ハ その他の本吸収分割契約の内容等

- 本吸収分割の日程
2024年1月(予定) 吸収分割契約締結

2024年4月1日(予定) 効力発生日

(注)本吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であるため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行います。

分割する部門の事業内容

ストレージを中心としたITインフラストラクチャ製品、サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

(中略)

その他の吸収分割契約の内容

吸収分割契約は、2024年1月に締結される予定です。

(4)本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割に係る割当ての内容について、現時点では確定していません。

(5)本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日立ヴァンタラ株式会社
本店の所在地	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
代表者の氏名	代表取締役社長 島田 朗伸
資本金の額	現時点では確定していません。
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	ストレージを中心としたデータインフラストラクチャ製品、データマネジメントソフトウェア、ハイブリッドクラウド基盤及びそれら関連サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

(訂正後)

(1)本吸収分割の相手会社についての事項

イ 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日立ヴァンタラ株式会社
本店の所在地	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
代表者の氏名	代表取締役 取締役社長 島田 朗伸
資本金の額	50百万円(2023年12月31日現在)
純資産の額	50百万円(2023年12月31日現在)
総資産の額	50百万円(2023年12月31日現在)
事業の内容	ストレージを中心としたデータインフラストラクチャ製品、データマネジメントソフトウェア、ハイブリッドクラウド基盤及びそれら関連サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

ロ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
現時点で終了した事業年度はありません。

ニ 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、日立ヴァンタラ株式会社の発行済株式の全てを所有しています。
人的関係	当社従業員1名が日立ヴァンタラ株式会社の取締役を兼務しています。
取引関係	本吸収分割の効力発生前は営業活動を行わないため、現時点で当社との取引関係はありません。

(3)本吸収分割の方法、割当ての内容、その他の本吸収分割契約の内容

ロ 本吸収分割に係る割当ての内容

日立ヴァンタラ株式会社は、本吸収分割に際して普通株式199,000株を発行し、その全てを当社に対して交付します。

八 その他の本吸収分割契約の内容等

本吸収分割の日程

2024年1月26日 吸収分割契約締結

2024年4月1日(予定) 効力発生日

(注)本吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であるため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行います。

分割する部門の事業内容

ストレージを中心としたデータインフラストラクチャ製品、データマネジメントソフトウェア、ハイブリッドクラウド基盤及びそれら関連サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

(中略)

債務履行の見込み

本吸収分割において、効力発生日以後に弁済期が到来する日立ヴァンタラ株式会社の債務(当社が吸収分割により承継させるものに限る。)について、履行の見込みはあるものと判断しています。

承継会社が承継する権利義務

日立ヴァンタラ株式会社は、本吸収分割契約に定める当社の資産、知的財産権等、債権債務及び契約上の地位、労働契約その他一切の権利義務を承継します。

(4)本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

当社が日立ヴァンタラ株式会社の発行済株式の全部を有することから、本吸収分割に際して、日立ヴァンタラ株式会社が普通株式199,000株を発行し、これを当社に交付することが相当であると判断しました。

(5)本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日立ヴァンタラ株式会社
本店の所在地	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
代表者の氏名	代表取締役 取締役社長 島田 朗伸
資本金の額	100億円
純資産の額	439億円(見込み)
総資産の額	935億円(見込み)
事業の内容	ストレージを中心としたデータインフラストラクチャ製品、データマネジメントソフトウェア、ハイブリッドクラウド基盤及びそれら関連サービスの設計・開発、日本国内の販売、運用、監視及び保守

以上